

SAS (Semiconductor & Assembly Solutions) 事業部

製品紹介

パワーエレクトロニクス向け接合剤

熱伝導率や信頼性など、各種ご要望に合わせて提案可能な様々な接合材料をご用意しています。

Argomax® シンター接合剤

アルファArgomax® シンター接合剤は、Tjmax 200°C以上のSiC/GaNパワーモジュール/デバイスの製造を可能とし、チップ接合の信頼性向上とトータルコストダウンに役立ちます。ハイブリッド自動車、EV、電力送電、鉄道等々に向けたインバータに最適です。高信頼性接合の鉛フリー化にも対応できます。

用途に合わせてペースト、フィルム、プリフォーム各種を取り揃えております。

製品シリーズ	概要	用途
Argomax® 2000	<ul style="list-style-type: none">・ マスク印刷用・ 標準品	<ul style="list-style-type: none">・ Au, Agメッキ
Argomax® 5000	<ul style="list-style-type: none">・ マスク印刷用・ Cu直接接合	<ul style="list-style-type: none">・ ディスクリート・ Cu-DBC
Argomax® 8000	<ul style="list-style-type: none">・ フィルム・ BLTコントロール	<ul style="list-style-type: none">・ ウェハー/ウェハー接合・ チップ転写・ ウェハー転写
Argomax® 9000	<ul style="list-style-type: none">・ プリフォーム	<ul style="list-style-type: none">・ 基板/基板接合・ 形状加工可

Atrox®導電性ペースト

アルファAtrox®導電性ペーストは、各種ダイアタッチ用途に適用し、無加圧ハイブリッド焼結剤として使用できます。高い熱伝導性（10~100W/mK）により、鉛フリーはんだパッケージの実現を可能にします。また、MSL1合格、RBO（レジソリッドアウト）の抑制、ドライアウト特性の向上により、高い信頼性が得られます。

Atrox®シリーズ

製品シリーズ	概要	用途
SE3001	<ul style="list-style-type: none"> 印刷、ディスペンス 130°C/15分、165°C/3分 	<ul style="list-style-type: none"> センサー Si直、Au、Agめっき
ATROX®800HT2V	<ul style="list-style-type: none"> ディスペンス 200°C/120分 	<ul style="list-style-type: none"> ディスクリート Au、Agめっき 5x5mm Si直 3x3mm
ATROX®800HT2V P1	<ul style="list-style-type: none"> 印刷 MSL1 200°C/120分 	<ul style="list-style-type: none"> ディスクリート Au、Agめっき 5x5mm
ATROX®850HT1 - ハイブリッド焼結Ag -	<ul style="list-style-type: none"> ディスペンス MSL 3 250°C/120分 	<ul style="list-style-type: none"> ディスクリート Au、Agめっき 10x10mm

PowerBond™ シリーズ

- ・ Tjmax=175°C
- ・ チップ接合およびヒートシンク接合に最適

PowerBond™2050

- ・ 融点 : 235-240°C

PowerBond™2110

- ・ 融点 : 222-266°C

TrueHeight® はんだプリフォーム

- ・ チップの傾きを防ぎ、接合厚みを均一にできる
- ・ 形状および厚みを自在に変えることができる
- ・ 安定した接合信頼性を得られる
 - ・ ボイドの原因となる揮発ガスを逃がしやすい
- ・ 最小接合厚み : 75um

PowerBond™及びTrueHeight®プリフォームは、薄いフラックス膜でコーティングすることができ、活性力が必要な接合箇所でも使用することができます。PowerBond™とTrueHeight®の組み合わせも可能です。



[前処理 めっき>](#)